

**ASMPT** enabling the  
digital world



**SIPLACE TX**

为智慧工厂提供最佳性能

# SIPLACE TX——完美的机器 为智慧工厂而生

智慧工厂需要智能机器：SIPLACE TX配备的全新CP20贴装头以及全新的SIPLACE Xi智能供料器，再一次刷新了其性能表现。

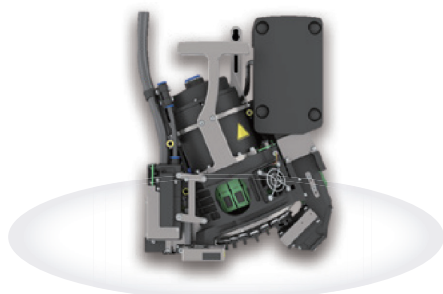
有了新的SIPLACE托盘单元和两个固定的高端相机系统，SIPLACE TX现在也可以用作节省空间的线端机器。它在输送系统、组件送料和智能软件选项方面具有独特的灵活性。

模块化，灵活，开放——SIPLACE TX通过标准接口和越来越多的自动化选项，无缝地融入ASMPT的开放式自动化概念并用于集成化智慧工厂，作为最先进的高性能产品，适用于各种类型的电子生产。



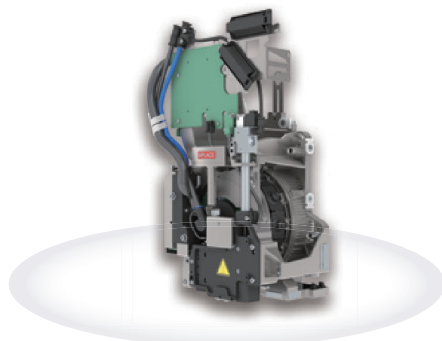
## 与众不同的 贴装头

3种创新的贴装头提供性能，灵活性和平衡



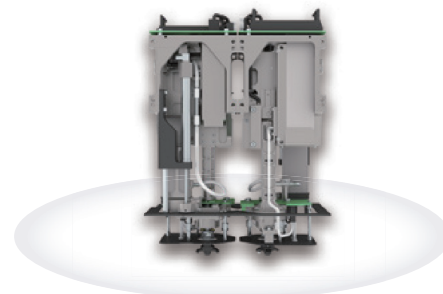
### CP20贴装头

- 48,000 cph – 对最大到8.2 mm x 8.2 mm的元器件贴装达到了新的速度标杆
- 贴装精度高：±25 μm
- 最高精度：新的元器件相机是为了更好的图像与更高的分辨率



### CPP贴装头

- 3种贴装模式：收集贴装、拾取贴装、及混合模式贴装
- 元器件范围高达50 x 40mm和最大高度可达15.5mm



### TWIN贴装头

- 元器件高度可达25mm
- 可用于贴装大型元器件 200 mm × 110 mm

# 智慧灵活性和 智慧性能

## 最大产能最小占地面积

96,000 cph, 机器尺寸只有1 m x 2.23 m

## 极大的元器件范围

元器件大小从0.12 mm × 0.12 mm到  
200 mm × 110 mm仅仅3个贴装头就可以全部覆盖

## 智能成像系统

每个元器件独立成像, 元器件特定光源参数设定,  
PCB检测, 异型元器件贴装, 裂纹检测以及更多。

## 灵活的轨道

双轨和长板选项,  
以及高度灵活的PCB传送选择。

## 非接触式贴装/低压力贴装

非接触式贴装及贴片压力低至0.5 N

## 精准元器件上料

80 × 8 mm供料器, 点胶供料器,  
SIPLACE智能供料器Xi, 线性浸渍单元

## 全新的: SIPLACE料盘单元

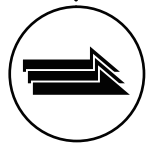
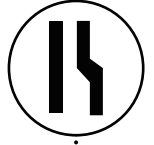
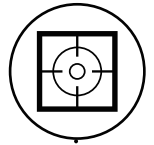
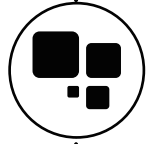
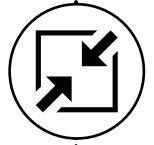
在紧凑的机柜里通过JEDEC和  
宽料盘快速和不间断的元器件供给



## 智能 和集成

### WORKS软件套件

凭借强大的WORKS软件, 您可以最大限度地利用您的生产线和SIPLACE TX, 同时减少员工的工作量, 控制和优化您的生产和物料流。AMR车队管理应用程序和企业解决方案(如MES和ERP软件)可以轻松连接。



关于SIPLACE TX  
的更多信息, 请扫描

# SIPLACE TX

机器类型	SIPLACE TX2i (item No. 588300)	SIPLACE TX2 (item No. 588302)	SIPLACE TX1 (item No. 588301)
贴装速度 (基准速度)	高达96,000 cph	高达85,500 cph	高达44,000 cph
机器尺寸 (长 x 宽 x 高)	1.00 m x 2.23 m x 1.45 m	1.00 m x 2.47 m x 1.45 m	1.00 m x 2.35 m x 1.45 m
贴装头	CP20贴装头, CPP贴装头, TWIN贴装头		
元器件范围	0.12 mm x 0.12 mm至200 mm x 110 mm**		
PCB尺寸 (长 x 宽)	50 mm x 45 mm至590 mm* x 260 mm (双轨) 50 mm x 45 mm至590 mm* x 460 mm (单轨模式)		
供料方式	高达80x8mm供料器, JEDEC料盘, 线性浸渍单元, 点胶供料器, 压力验证供料器, SIPLACE料盘单元		
耗电量	2.0 KW (配备真空泵) 1.2 KW (不配备真空泵)		
耗气量	120 NI/min (配备真空泵)		70 NI/min (配备真空泵)

\* 长板选项 (非长板选项时, PCB最大长度为375 mm)

\*\* 有限制条件

贴装头	Placement Head CP20	Placement Head CPP	Placement Head TWIN
元器件范围	0.12 mm x 0.12 mm 至8.2 mm x 8.2 mm	01005至50 mm x 40 mm	0201至200 mm x 110 mm
元器件高度	4 mm	15.5 mm	25 mm
贴装精度(3 $\sigma$ )	25 $\mu$ m	34 $\mu$ m	22 $\mu$ m
最佳性能 (基准速度)	48,000 cph	25,500 cph	5,500 cph
贴装压力	0.5 N至4.5 N	1.0 N至15 N	1.0 N至30 N

通过ASMP T推荐的适当间隔和范围内的专业维护, 确保您的SIPLACE设备在整个产品周期内实现预定的性能和精度。我们的多种维护合同会让您的工作更简单。

## ASMP T

先进装配系统有限公司

上海市东育路227弄3号前滩世贸中心二期C栋3层 | 电话: +86 21 58873030 | E-mail: smt-solutions.cn@asmpt.com

asmpt.com | smt.asmpt.com

16/02-2024版 | 保留所有权利 | 订购号: A22-ASMP T-A327-ZH | 中国印刷 | ©ASMP T GmbH & Co.KG

本手册中的所有信息和插图均以“概不保证”的方式提供, 不含任何明确或隐含的担保, 包括但不限于对质量满意、适用于特定用途和/或正确性的隐含担保。

本手册的内容仅供参考, 不构成建议, 如有更改, 恕不另行通知。ASMP T在法律允许的最大范围内, 对本手册中包含的内容、细节、规格或信息的正确性、准确性、充分性、实用性、及时性、可靠性或其他方面的使用不作任何保证或声明。请联系ASMP T以获取最新信息。仅在达成协议的情况下, 特定性能特性和/或功能才具有法律效力。

所有产品名称均为ASMP T或其他供应商的品牌或者商标。第三方使用需经所有者授权。